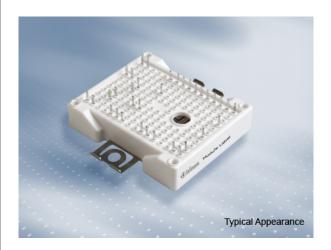
IGBT-モジュール IGBT-Module

F3L200R12W2H3_B11



EasyPACK モジュール ニュートラル ポイント クランプ2 トポロジー内蔵 and PressFIT / NTCサーミスタ EasyPACK module with active "Neutral Point Clamp 2" topology and PressFIT / NTC



一般応用

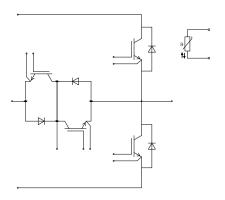
- ・3レベル アプリケーション
- モーター駆動
- ・ソーラーアプリケーション
- UPSシステム

電気的特性

- 高速IGBT H3
- 低スイッチング損失
- $T_{vi op} = 150^{\circ}C$

機械的特性

- 3 kV AC 1分 絶縁耐圧
- PressFIT 接合 技術
- RoHS対応



V_{CES} = 1200V

 $I_{C \text{ nom}} = 100A / I_{CRM} = 200A$

Typical Applications

- 3-level-applications
- · Motor drives
- Solar applications
- UPS systems

Electrical Features

- High speed IGBT H3
- · Low switching losses
- $T_{vi op} = 150^{\circ}C$

Mechanical Features

- 3 kV AC 1min insulation
- · PressFIT contact technology
- RoHS compliant

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the CodeDigitModule Serial Number1 - 5Module Material Number6 - 11Production Order Number12 - 19Datecode (Production Year)20 - 21Datecode (Production Week)22 - 23

prepared by: CM	date of publication: 2016-04-04	
approved by: AKDA	revision: V3.1	UL approved (E83335)

IGBT-モジュール IGBT-Module

F3L200R12W2H3_B11



IGBT, T1 / T4 / IGBT, T1 / T4

最大定格 / Maximum Rated Values

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25$ °C	V _{CES}		1200		٧
コレクタ電流 Implemented collector current		I _{CN}		200		А
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	T _C = 100°C, T _{vj max} = 175°C	I _{C nom}		100		А
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I _{CRM}		400		А
トータル損失 Total power dissipation	T _C = 25°C, T _{vj max} = 175°C	P _{tot}		600		W
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		V _{GES}		+/-20		٧
電気的特性 / Characteristic Val	ues		min.	typ.	max.	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-emitter saturation voltage	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			1,55 1,70 1,75	1,75	V V
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	I _C = 7,60 mA, V _{CE} = V _{GE} , T _{vj} = 25°C	V_{GEth}	5,05	5,80	6,45	٧
ゲート電荷量 Gate charge	V _{GE} = -15 V +15 V	Q_{G}		1,60		μC
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	T _{vj} = 25°C	R _{Gint}		3,8		Ω
入力容量 Input capacitance	f = 1 MHz, T _{vj} = 25°C, V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V	C _{ies}		11,5		nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T _{vj} = 25°C, V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V	C _{res}		0,70		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	V _{CE} = 1200 V, V _{GE} = 0 V, T _{vj} = 25°C	I _{CES}			1,0	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	V _{CE} = 0 V, V _{GE} = 20 V, T _{vj} = 25°C	I _{GES}			100	nA
ターンオン遅れ時間(誘導負荷) Turn-on delay time, inductive load	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0,14 0,155 0,16		μs μs μs
ターンオン上昇時間(誘導負荷) Rise time, inductive load	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0,025 0,03 0,03		μs μs μs
ターンオフ遅れ時間(誘導負荷) Turn-off delay time, inductive load	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	t _{d off}		0,32 0,40 0,42		μs μs μs
ターンオフ下降時間(誘導負荷) Fall time, inductive load	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0,03 0,055 0,06		μs μs μs
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	$\begin{array}{c} I_{C} = 100 \text{ A, } V_{CE} = 400 \text{ V, } L_{S} = 25 \text{ nH} & T_{vj} = 25^{\circ}\text{C} \\ V_{GE} = \pm 15 \text{ V, } \text{di/dt} = 3700 \text{ A/µs} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}) & T_{vj} = 125^{\circ}\text{C} \\ R_{Gon} = 1,1 \Omega & T_{vj} = 150^{\circ}\text{C} \end{array}$			1,20 2,00 2,25		mJ mJ mJ
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	$\begin{array}{c} I_{C} = 100 \text{ A, } V_{CE} = 400 \text{ V, } L_{S} = 25 \text{ nH} \\ V_{GE} = \pm 15 \text{ V, } du/dt = 2700 \text{ V/}\mu\text{s } (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})T_{vj} = 125^{\circ}\text{C} \\ R_{Goff} = 1,1 \Omega \\ \end{array}$			3,50 5,30 5,90		mJ mJ mJ
短絡電流 SC data	$V_{GE} \le 15 \text{ V}, V_{CC} = 800 \text{ V} \\ V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$ $t_P \le 10 \mu s, \ T_{vj} = 150 ^{\circ} \text{C}$, I _{sc}		800		А
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	IGBT部(1素子当り) / per IGBT	R _{thJC}		0,200	0,250	K/W

prepared by: CM	date of publication: 2016-04-04
approved by: AKDA	revision: V3.1

$_{\text{IGBT-HOdule}}^{\text{IGBT-HOJULE}} \quad F3L200R12W2H3_B11$



ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	IGBT部(1素子当り) / per IGBT λ _{Paste} = 1 W/(m·K) / λ _{grease} = 1 W/(m·K)	R _{thCH}		0,200		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions		T _{vj op}	-40		150	°C

ダイオード, D2 / D3 / Diode, D2 / D3

最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}C$	V_{RRM}	650	V
順電流 Implemented forward current		I _{FN}	125	А
連続DC電流 Continuous DC forward current		I _F	100	А
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	t_P = 1 ms	I _{FRM}	250	А
電流二乗時間積 l²t - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	l²t	1450 1400	A²s A²s

電気的特性 / Characteristic Values			min.	typ.	max.		
順電圧 Forward voltage	I _F = 100 A, V _{GE} = 0 V I _F = 100 A, V _{GE} = 0 V I _F = 100 A, V _{GE} = 0 V	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	V _F		1,55 1,50 1,45	1,70	>>>
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$ I_F = 100 \text{ A, - } di_F/dt = 3700 \text{ A/}\mu\text{s } (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}) $ $V_R = 400 \text{ V} $ $V_{GE} = -15 \text{ V} $	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	I _{RM}		90,0 100 100		A A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$ I_F = 100 \text{ A, - } di_F/dt = 3700 \text{ A/}\mu\text{s } (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}) $ $V_R = 400 \text{ V} $ $V_{GE} = -15 \text{ V} $	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	Qr		3,25 5,90 6,40		μC μC μC
逆回復損失 Reverse recovery energy	$ I_F = 100 \text{ A, - di}_F/dt = 3700 \text{ A/}\mu\text{s } (T_{vj} = 150 ^{\circ}\text{C}) $ $V_R = 400 \text{ V} $ $V_{GE} = -15 \text{ V} $	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	E _{rec}		0,95 1,55 1,65		mJ mJ mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode(1素子当り) / per diode		R _{thJC}		0,550	0,650	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode(1素子当り) / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)		R _{thCH}		0,600		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			T _{vj op}	-40		150	°C

prepared by: CM	date of publication: 2016-04-04
approved by: AKDA	revision: V3.1

IGBT-モジュール IGBT-Module

F3L200R12W2H3_B11



IGBT, T2 / T3 / IGBT, T2 / T3

最大定格 / Maximum Rated Values

取入正价/Waximum Rated Value	5					
コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	T _{vj} = 25°C	V _{CES}		650		٧
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	T _C = 100°C, T _{vj max} = 175°C	I _{C nom}		100		Α
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	t _P = 1 ms	I _{CRM}		200		А
トータル損失 Total power dissipation	T _C = 25°C, T _{vj max} = 175°C	P _{tot}		250		w
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		V _{GES}		+/-20		٧
=====================================	•		min.	typ.	max.	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-emitter saturation voltage	$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	V _{CE sat}		1,45 1,60 1,70	1,90	V V V
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	I _C = 1,60 mA, V _{CE} = V _{GE} , T _{vj} = 25°C	V_{GEth}	4,95	5,80	6,45	V
ゲート電荷量 Gate charge	V _{GE} = -15 V +15 V	Q_{G}		1,00		μC
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	$T_{vj} = 25$ °C	R _{Gint}		2,0		Ω
入力容量 Input capacitance	f = 1 MHz, T _{vj} = 25°C, V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V	C _{ies}		6,20		nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T _{vj} = 25°C, V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V	C _{res}		0,19		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	V _{CE} = 650 V, V _{GE} = 0 V, T _{vj} = 25°C	I _{CES}			1,0	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	V _{CE} = 0 V, V _{GE} = 20 V, T _{vj} = 25°C	I _{GES}			100	nA
ターンオン遅れ時間(誘導負荷) Turn-on delay time, inductive load	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	t _{d on}		0,055 0,06 0,065		μs μs μs
ターンオン上昇時間(誘導負荷) Rise time, inductive load	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	tr		0,025 0,03 0,03		μs μs μs
ターンオフ遅れ時間(誘導負荷) Turn-off delay time, inductive load	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	t _{d off}		0,25 0,27 0,28		μs μs μs
ターンオフ下降時間(誘導負荷) Fall time, inductive load	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	t _f		0,035 0,05 0,06		μs μs μs
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	$\begin{array}{c} I_{C} = 100 \text{ A, V}_{CE} = 400 \text{ V, L}_{S} = 25 \text{ nH} & T_{vj} = 25^{\circ}\text{C} \\ V_{GE} = \pm 15 \text{ V, di/dt} = 3800 \text{ A/µs} & (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}) & T_{vj} = 125^{\circ}\text{C} \\ R_{Gon} = 3,3 \ \Omega & T_{vj} = 150^{\circ}\text{C} \\ \end{array}$	E _{on}		1,85 2,80 3,30		mJ mJ mJ
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	$\begin{array}{l} I_{C} = 100 \text{ A, V}_{CE} = 400 \text{ V, L}_{S} = 25 \text{ nH} & T_{vj} = 25^{\circ}\text{C} \\ V_{GE} = \pm 15 \text{ V, du/dt} = 4600 \text{ V/µs} & (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}) \\ T_{vj} = 125^{\circ}\text{C} \\ R_{Goff} = 3,3 \Omega & T_{vj} = 150^{\circ}\text{C} \end{array}$	E _{off}		3,10 4,10 4,60		mJ mJ mJ
短絡電流 SC data	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	I _{sc}		700 500		A A
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	IGBT部(1素子当り) / per IGBT	R _{thJC}		0,500	0,600	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	IGBT部(1素子当り) / per IGBT λ _{Paste} = 1 W/(m·K) / λ _{grease} = 1 W/(m·K)	R _{thCH}		0,500		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions		T _{vj op}	-40		150	°C

prepared by: CM	date of publication: 2016-04-04
approved by: AKDA	revision: V3.1

IGBT-モジュール IGBT-Module

F3L200R12W2H3_B11



ダイオード, D1 / D4 / Diode, D1 / D4

日上宀垆	/ Maximum	D 4 13/1	
一大七枚	/ Mavimiim	Patod Val	IIAC

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	T _{vj} = 25°C	V _{RRM}	1200	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		l _F	75	Α
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	t _P = 1 ms	I _{FRM}	150	Α
電流二乗時間積 l²t - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	l²t	1050 985	A²s A²s

電気的特性 / Characteristic Values	6			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$ I_F = 75 \text{ A, } V_{GE} = 0 \text{ V} $ $ I_F = 75 \text{ A, } V_{GE} = 0 \text{ V} $ $ I_F = 75 \text{ A, } V_{GE} = 0 \text{ V} $	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	V _F		1,65 1,65 1,65	2,15	V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	I_F = 75 A, - di _F /dt = 3500 A/µs (T_{vj} =150°C) V_R = 400 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	I _{RM}		120 140 150		A A A
逆回復電荷量 Recovered charge	I_F = 75 A, - di _F /dt = 3500 A/µs (T _{vj} =150°C) V_R = 400 V V_{GE} = -15 V	$T_{vj} = 25^{\circ}C$ $T_{vj} = 125^{\circ}C$ $T_{vj} = 150^{\circ}C$	Qr		8,50 17,0 19,0		μC μC μC
逆回復損失 Reverse recovery energy	I_F = 75 A, - di _F /dt = 3500 A/µs (T_{vj} =150°C) V_R = 400 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C T_{vj} = 150°C	E _{rec}		2,85 5,70 6,30		mJ mJ mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode(1素子当り) / per diode		R _{thJC}		0,550	0,600	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode(1素子当り) / per diode λ _{Paste} = 1 W/(m·K) / λ _{grease} = 1 W/(m·K)		R _{thCH}		0,500		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			T _{vj op}	-40		150	°C

モジュール / Module

L フュール / Module						
絶縁耐圧 Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}		3,0		kV
内部絶縁 Internal isolation	基礎絶縁 (クラス1, IEC 61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)			Al ₂ O ₃		
沿面距離 Creepage distance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal			11,5 6,3		mm
空間距離 Clearance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal			10,0 5,0		mm
相対トラッキング指数 Comperative tracking index		СТІ		> 200		
			min.	typ.	max.	
内部インダクタンス Stray inductance module		L _{sCE}		14		nH
保存温度 Storage temperature		T _{stg}	-40		125	°C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder mountig force per clamp		F	40	-	80	N
質量 Weight		G		36		g

Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 25A effektiv pro Anschlusspin begrenzt. The current under continuous operation is limited to 25A rms per connector pin.

prepared by: CM	date of publication: 2016-04-04
approved by: AKDA	revision: V3.1

IGBT-モジュール IGBT-Module

F3L200R12W2H3_B11



NTC-サーミスタ / NTC-Thermistor

電気的特性 / Characteristic Values		min.	typ.	max.		
定格抵抗值 Rated resistance	T _{NTC} = 25°C	R ₂₅		5,00		kΩ
R100の偏差 Deviation of R100	T_{NTC} = 100°C, R_{100} = 493 Ω	ΔR/R	-5		5	%
損失 Power dissipation	T _{NTC} = 25°C	P ₂₅			20,0	mW
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	B _{25/50}		3375		К
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	B _{25/80}		3411		К
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	B _{25/100}		3433		К

適切なアプリケーションノートによる仕様

Specification according to the valid application note.

prepared by: CM	date of publication: 2016-04-04
approved by: AKDA	revision: V3.1

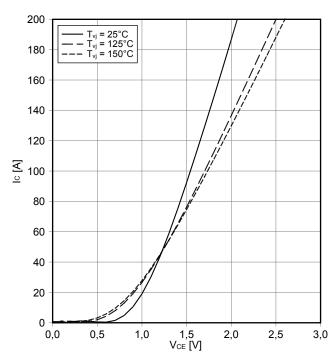
IGBT-モジュール IGBT-Module

F3L200R12W2H3_B11

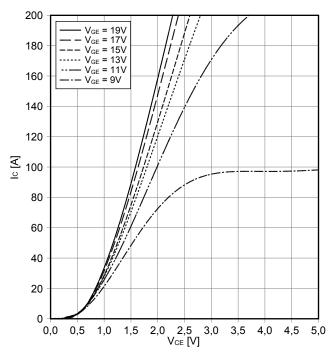


出力特性 IGBT, T1 / T4 (Typical) output characteristic IGBT, T1 / T4 (typical) lc = f (VCE)

 $V_{GE} = 15 \text{ V}$

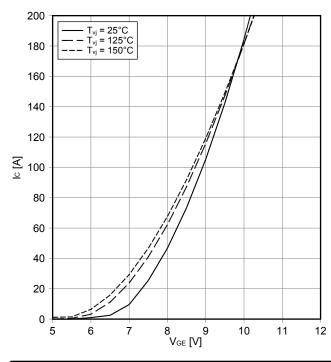


出力特性 IGBT, T1 / T4 (Typical) output characteristic IGBT, T1 / T4 (typical) $I_C = f(V_{CE})$ $T_{v_j} = 150^{\circ}C$



伝達特性 IGBT, T1 / T4 (Typical) transfer characteristic IGBT, T1 / T4 (typical)

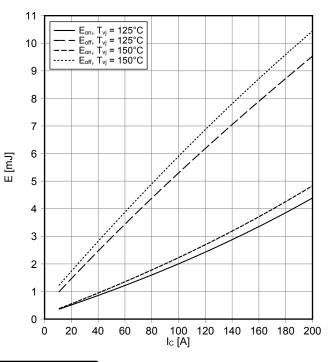
 $I_C = f(V_{GE})$ $V_{CE} = 20 V$



スイッチング損失 IGBT, T1 / T4 (Typical) switching losses IGBT, T1 / T4 (typical)

 $E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C)$

 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 1.1 \Omega, R_{Goff} = 1.1 \Omega, V_{CE} = 400 \text{ V}$



prepared by: CM	date of publication: 2016-04-04
approved by: AKDA	revision: V3.1

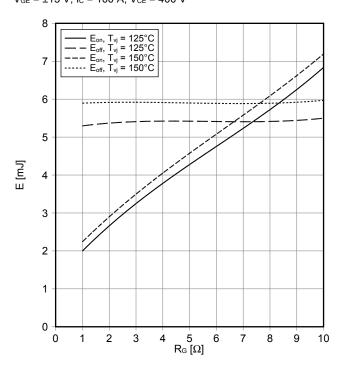
IGBT-モジュール IGBT-Module

F3L200R12W2H3_B11

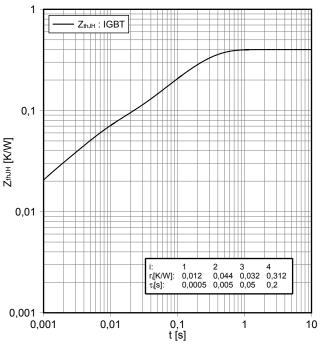


スイッチング損失 IGBT, T1 / T4 (Typical) switching losses IGBT, T1 / T4 (typical)

E_{on} = f (R_G), E_{off} = f (R_G) V_{GE} = ±15 V, I_C = 100 A, V_{CE} = 400 V

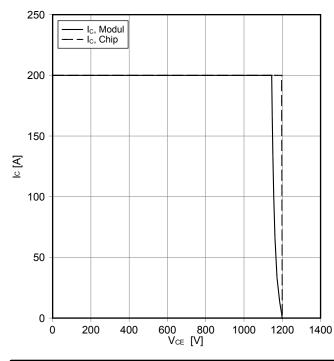


過渡熱インピーダンス IGBT, T1 / T4 transient thermal impedance IGBT, T1 / T4 Z_{thJH} = f (t)

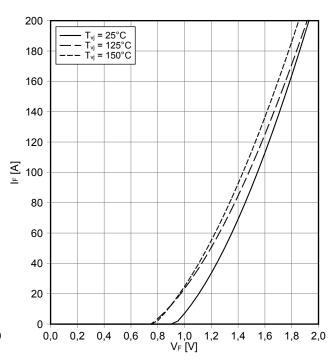


逆パイアス安全動作領域 IGBT, T1 / T4 (RBSOA)) reverse bias safe operating area IGBT, T1 / T4 (RBSOA) I_C = f (V_{CE})

 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 1.1 \Omega, T_{vi} = 150 ^{\circ}\text{C}$



順電圧特性 ダイオード, D2 / D3 (typical) forward characteristic of Diode, D2 / D3 (typical) I_F = f (V_F)



prepared by: CM	date of publication: 2016-04-04
approved by: AKDA	revision: V3.1

IGBT-モジュール IGBT-Module

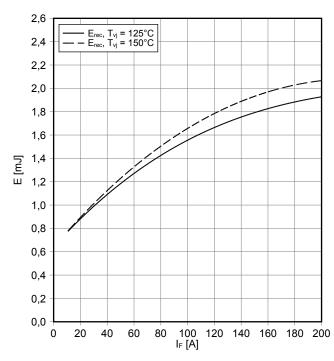
F3L200R12W2H3_B11



スイッチング損失 ダイオード, D2 / D3 (Typical) switching losses Diode, D2 / D3 (typical)

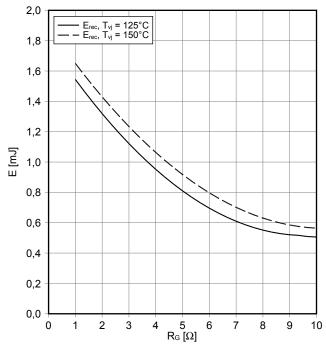
 $E_{rec} = f(I_F)$

 $R_{Gon} = 1.1 \Omega$, $V_{CE} = 400 V$

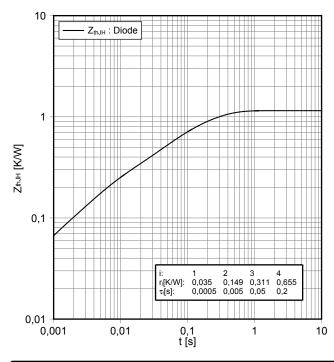


スイッチング損失 ダイオード, D2 / D3 (Typical) switching losses Diode, D2 / D3 (typical) $E_{\rm rec}$ = f ($R_{\rm G}$)

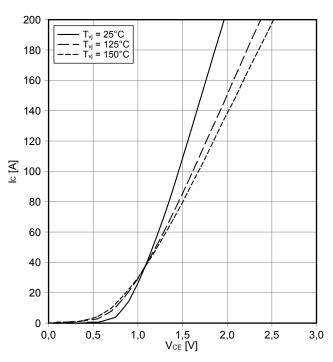
 $I_F = 100 \text{ A}, V_{CE} = 400 \text{ V}$



過渡熱インピーダンス ダイオード, D2 / D3 transient thermal impedance Diode, D2 / D3 Z_{thJH} = f (t)



出力特性 IGBT, T2 / T3 (Typical) output characteristic IGBT, T2 / T3 (typical) $I_C = f \ (V_{CE})$ $V_{GE} = 15 \ V$



prepared by: CM	date of publication: 2016-04-04
approved by: AKDA	revision: V3.1

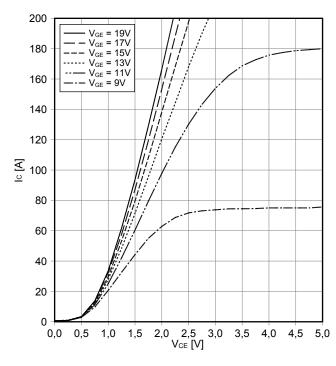
IGBT-モジュール IGBT-Module

F3L200R12W2H3_B11

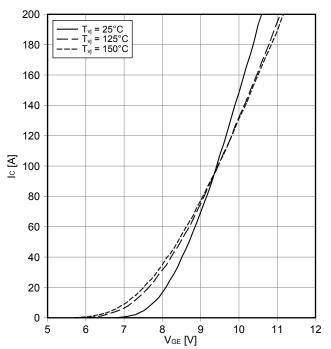


出力特性 IGBT, T2 / T3 (Typical) output characteristic IGBT, T2 / T3 (typical) lc = f (VcE)

 $T_{vj} = 150^{\circ}C$

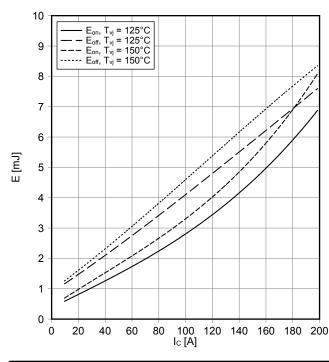


伝達特性 IGBT, T2 / T3 (Typical) transfer characteristic IGBT, T2 / T3 (typical) $I_C = f \ (V_{GE})$ $V_{CE} = 20 \ V$



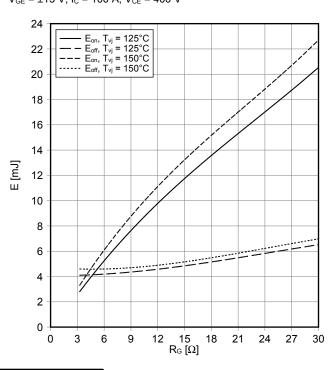
スイッチング損失 IGBT, T2 / T3 (Typical) switching losses IGBT, T2 / T3 (typical)

 $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 3.3 \Omega$, $R_{Goff} = 3.3 \Omega$, $V_{CE} = 400 \text{ V}$



スイッチング損失 IGBT, T2 / T3 (Typical) switching losses IGBT, T2 / T3 (typical)

 $E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G)$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 100 \text{ A}, V_{CE} = 400 \text{ V}$



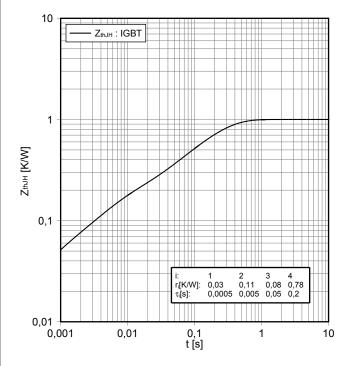
prepared by: CM	date of publication: 2016-04-04
approved by: AKDA	revision: V3.1

IGBT-モジュール IGBT-Module

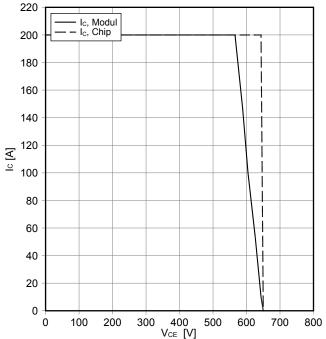
F3L200R12W2H3_B11



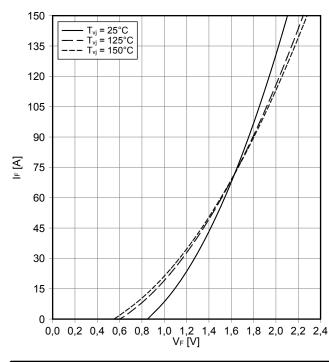
過渡熱インピーダンス IGBT, T2 / T3 transient thermal impedance IGBT, T2 / T3 $Z_{\text{thJH}} = f\left(t\right)$



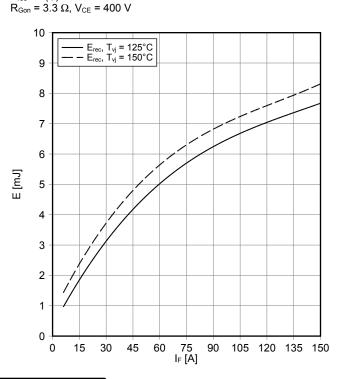
逆バイアス安全動作領域 IGBT, T2 / T3 (RBSOA)) reverse bias safe operating area IGBT, T2 / T3 (RBSOA) $I_C=f$ (V_{CE}) $V_{GE}=\pm15$ V, $R_{Goff}=3.3$ Ω , $T_{vj}=150$ °C



順電圧特性 ダイオード, D1 / D4 (typical) forward characteristic of Diode, D1 / D4 (typical) I_F = f (V_F)



スイッチング損失 ダイオード, D1 / D4 (Typical) switching losses Diode, D1 / D4 (typical) $E_{\text{rec}} = f\left(I_F\right)$



prepared by: CM	date of publication: 2016-04-04
approved by: AKDA	revision: V3.1

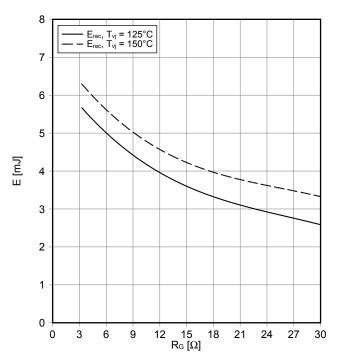
IGBT-モジュール IGBT-Module

F3L200R12W2H3_B11

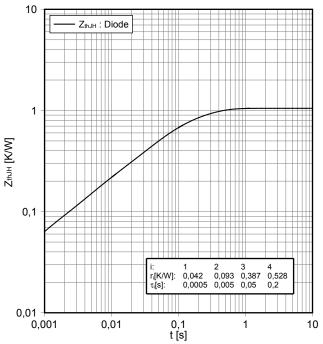


スイッチング損失 ダイオード, D1 / D4 (Typical) switching losses Diode, D1 / D4 (typical) $E_{rec} = f(R_G)$

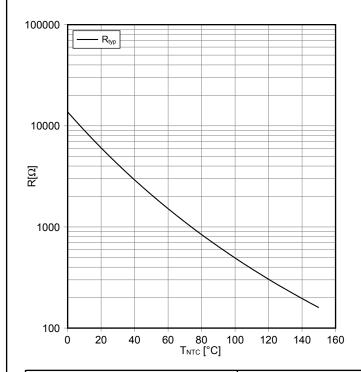
 $I_F = 75 \text{ A}, V_{CE} = 400 \text{ V}$



過渡熱インピーダンス ダイオード, D1 / D4 transient thermal impedance Diode, D1 / D4 $Z_{thJH} = f(t)$



NTC-サーミスタ サーミスタの温度特性 NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical) R = f (T)



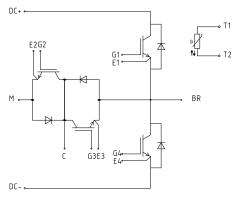
prepare	d by: CM	date of publication: 2016-04-04
approve	d by: AKDA	revision: V3.1

IGBT-モジュール **IGBT-Module**

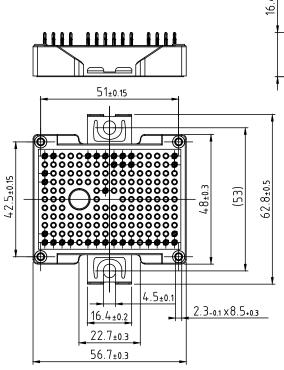
F3L200R12W2H3 B11

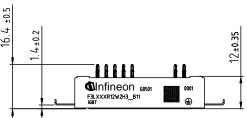


回路図 / Circuit diagram



パッケージ概要 / Package outlines

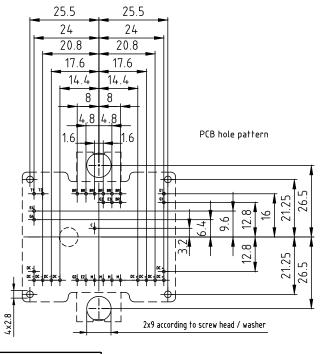




- Pin-Grid 3.2mm
- Tolerance of PCB hole pattern $\left| \bigoplus \right|$ ϕ 0.1
- Hole specification for contacts see AN 2009-01:

Diameters of drill Ø 1.15mm

and copper thickness in hole 25-50µm



prepared by: CM	date of publication: 2016-04-04
approved by: AKDA	revision: V3.1

IGBT-モジュール IGBT-Module

F3L200R12W2H3_B11



Published by Infineon Technologies AG 81726 München, Germany © Infineon Technologies AG 2015. All Rights Reserved.

この日本訳は、あくまで参考訳となりますので、正式はデータシートに記載されている英文の物となります。

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません(「品質の保証」)。 本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的価値、および / または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ(以下、「インフィニオン」)はここに、第三者の知的所有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文 書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

本製品、技術、納品条件、および価格についての詳しい情報は、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください(www.infineon.com)。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、 当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできない こと予めご了承ください

Terms & Conditions of usage

IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can

reasonably be expected to result in personal injury.

prepared by: CM	date of publication: 2016-04-04
approved by: AKDA	revision: V3.1